



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2018. november 21.
(OR. en)

14559/18
ADD 1

ENV 797
MI 870
DELECT 153

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2018. november 19.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	C(2018) 7499 final - Annex
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a C(2018) 7499 final számú dokumentum mellékletét.

Melléklet: C(2018) 7499 final - Annex



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2018.11.16.
C(2018) 7499 final

ANNEX

MELLÉKLET

a következőhöz:

A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve

a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő ólomra megadott mentesség tekintetében, a tudományos és a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról

MELLÉKLET

A III. mellékletben a 15. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„15.	Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő ólom	A mentesség a 8., a 9. és a 11. kategóriára vonatkozik, és a következő időpontokban lejár: – a 8. és a 9. kategóriába tartozó, az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközöktől, valamint az ipari felügyeleti és vezérlő eszközöktől eltérő eszközök esetében 2021. július 21-én, – a 8. kategóriába tartozó in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök esetében 2023. július 21-én, – a 9. kategóriába tartozó ipari felügyeleti és vezérlő eszközök és a 11. kategória esetében 2024. július 21-én.
15. a)	Tokozott flip chip integrált áramkörökben a félvezető chip és a hordozó között működőképes elektromos kapcsolatot megvalósító forrasztóanyagban lévő ólom, amennyiben a következő kritériumok közül legalább egy teljesül: – 90 nm-es vagy annál nagyobb félvezető technológiai csomópont, – 300 mm²-es vagy annál nagyobb egyedülálló chip bármely félvezető technológiájú csomópontban, – 300 mm²-es vagy annál nagyobb chipek, vagy 300 mm²-es vagy annál nagyobb szilícium távtartó rétegek több, egymásra helyezett chipet tartalmazó tokozásokban.	A mentesség az 1–7. és a 10. kategóriára vonatkozik, és 2021. július 21-én lejár.”